

中国半导体展-2024半导体展会、集成电路博览会

产品名称	中国半导体展-2024半导体展会、集成电路博览会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会的成功举办，不仅为半导体产业提供了一个展示、交流创新理念的平台，也为推动产业发展、加强国际合作发挥了重要作用。相信在未来，随着半导体技术的不断发展和创新，我们将迎来更加美好的科技生活。

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,000m²，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。

展览会期间，与会者纷纷表示，SEMI-e2024为半导体产业带来了无限机遇和挑战。一方面，随着全球科技的不断进步，半导体作为支撑各行业发展的核心基础，其市场需求将持续增长。另一方面，随着技术的日新月异，半导体产业正面临着一系列技术难题和市场挑战，需要不断创新和突破。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9、电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

在技术创新方面，参展商们展示了众多前沿技术，如新一代芯片制造工艺、5G通信技术、人工智能芯片等。这些技术为半导体产业的发展提供了源源不断的动力。同时，各企业也在积极探索新的合作模式，通过产学研一体化、跨界合作等方式，共同推动半导体技术的突破和发展。

在市场拓展方面，SEMI-e2024为参展商提供了一个展示产品、拓展市场的机会。通过与全球各地的客户、合作伙伴面对面交流，企业能够更好地了解市场需求，拓展业务渠道，实现互利共赢。此外，展览会还吸引了众多投资者和媒体关注，为半导体产业的融资和品牌建设提供了有力支持。